

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰



**温州宏丰电工合金股份有限公司**

**WENZHOU HONGFENG ELECTRICAL ALLOY CO.,LTD.**

(注册地址：浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区)

**2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案**

二〇二六年二月

## 公司声明

- 1、公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
- 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。
- 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
- 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
- 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
- 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。

## 特别提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

1、本次向特定对象发行股票方案已经公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过，尚需获得公司股东会的批准，并取得深交所审核通过且经中国证监会同意注册后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。

2、本次向特定对象发行股票的对象不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式，按照统一价格认购公司本次发行的股票。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

3、本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于本次发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会根据股东会的授权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。

4、本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前剔除库存股后的公司总股本的 30%，即不超过 149,093,466 股（含本数）。

最终发行数量由公司股东会授权董事会及其授权人士根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次董事会决议公告日至发行期间发生派发股利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致发行前公司总股本减去库存股的数量发生变动的，则本次发行数量上限进行相应调整。

5、本次向特定对象发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定，本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让。限售期结束后减持按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行对象所取得上市公司的股份因上市公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。

6、本次发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但是不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

7、公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

8、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 45,000.00 万元（含本数），在扣除发行费用后将应用于以下项目：

单位：万元				
序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	实施主体
1	锂电铜箔及电子铜箔扩产项目	28,000.00	28,000.00	浙江宏丰铜箔有限公司
2	半导体蚀刻引线框架项目	17,000.00	17,000.00	浙江宏丰半导体新材料有限公司
合计		45,000.00	45,000.00	-

9、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，公司制订了《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。关于公司利润分配政策、最近三年现金分红情况及未来三年股东回报规划等，请参见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”的相关披露。

10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的

意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关情况详见本预案“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺”。

本预案中公司对本次发行完成后每股收益的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。

11、特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”有关内容，注意投资风险。

12、本次向特定对象发行股票方案最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定，尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。

# 目录

公司声明 .....	2
特别提示 .....	3
<b>目录 .....</b>	<b>6</b>
<b>释义 .....</b>	<b>8</b>
<b>第一节 本次发行方案概要 .....</b>	<b>10</b>
一、公司基本情况 .....	10
二、本次向特定对象发行的背景和目的 .....	10
三、发行对象及其与公司的关系 .....	14
四、本次向特定对象发行股票的方案 .....	15
五、本次发行是否构成关联交易 .....	18
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 .....	18
七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 .....	18
八、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件 .....	19
<b>第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .....</b>	<b>20</b>
一、本次募集资金使用投资计划 .....	20
二、本次募集资金投资项目的具体情况 .....	20
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 .....	31
四、本次募集资金投资项目可行性分析结论 .....	32
<b>第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .....</b>	<b>33</b>
一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响 .....	33
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .....	33
三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争的变化情况 .....	34
四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 .....	34
五、本次发行对公司负债情况的影响 .....	35
六、本次股票发行相关的风险说明 .....	35

<b>第四节 公司利润分配政策及执行情况</b>	39
一、公司现行的利润分配政策	39
二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	41
三、公司未来三年股东分红回报规划	42
<b>第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺</b>	46
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明	46
二、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	46
三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性	49
四、本次募投项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面储备情况	49
五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施	51
六、公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺	52

## 释义

在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

发行人、上市公司、公司、温州宏丰、本公司	指	温州宏丰电工合金股份有限公司
浙江宏丰铜箔	指	浙江宏丰铜箔有限公司
宏丰半导体	指	浙江宏丰半导体新材料有限公司
本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票	指	温州宏丰 2026 年度向特定对象发行 A 股股票
股东会	指	温州宏丰电工合金股份有限公司股东会
董事会	指	温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
定价基准日	指	本次向特定对象发行股票的定价基准日。根据《上市公司证券发行注册管理办法》，本次向特定对象发行股票定价基准日为发行期首日
A 股	指	每股面值 1.00 元的人民币普通股
本预案	指	《温州宏丰电工合金股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》
报告期	指	2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-9 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《发行办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》	指	《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》
动力电池	指	为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池，具有体积大、容量高、强度高，抗冲击性强的特点，技术要求较高
锂电铜箔	指	在锂离子电池中，作为负极集流体，既充当负极又充当负极电子流的收集与传输体，对锂离子电池的电化学性能有很大的影响，是提高锂离子电池性能的关键材料之一
电子电路铜箔、电子铜箔	指	电子信息产业的基础原材料，用于与绝缘基材压合的一种电子基础材料，集中在三个方面应用：单双面覆铜板（CCL）制作用；多层印制电路板（PCB）用；电器元件电磁屏蔽用
引线框架	指	集成电路的芯片载体，是一种借助于键合材料（金丝、铝丝、铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件，它起到了和外部导线连接的桥梁作用
蚀刻引线框架	指	采用蚀刻工艺生产的引线框架，区别于冲压工艺生产的引线框架，属于比较高端的产品
覆铜板、CCL	指	COPPER CLAD LAMINATE，中文全称覆铜板层压板，是由木浆纸或玻纤布等作增强材料，浸以树脂，单面或双面覆以铜箔，经热压而成的一种产品，是电子工业的基础材料，又名基材，主要用于加工制造印制电路板
印制电路板、PCB	指	PRINTED CIRCUIT BOARD，中文名又称印刷电路板、印刷线路板，是指在绝缘基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，是电子元器件的支撑体、电子元器件电气连接的载体

---

元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
---------	---	------------------

---

注：本预算案除特别说明外，所有数值保留两位小数，若出现总数的尾数与各分项数值总和的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 本次发行方案概要

### 一、公司基本情况

公司名称	温州宏丰电工合金股份有限公司
英文名称	Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
统一社会信用代码	91330000256018570F
设立日期	1997年9月11日
注册资本	496,978,222元
法定代表人	陈晓
注册地址	浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区
办公地址	浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号
邮政编码	325000
股票代码	300283
股票简称	温州宏丰
股票上市地	深交所
董事会秘书	严学文
联系电话	0577-85515911
传真号码	0577-85515915
公司网址	www.wzhf.com
电子信箱	zqb@wzhf.com
经营范围	贵金属合金材料（强电电触点、弱电微触点），电器配件生产、加工、销售；金属材料销售；货物进出口、技术进出口，产品检测与评定认可（范围及期限详见《认可证书》）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 二、本次向特定对象发行的背景和目的

#### （一）本次向特定对象发行股票的背景

##### 1、铜箔行业持续增长，高端市场潜力巨大

电解铜箔是指以铜料为主要原料，采用电解法生产的金属铜箔。作为电子信息行业的功能性关键基础原材料，电解铜箔主要用于锂离子电池和印制电路板（PCB）。根据应用领域的不同，电解铜箔可以分为锂电铜箔和电子铜箔。

锂电铜箔是生产锂电池电芯的重要材料，它是负极活性物质的载体，主要作用是将

电池活性物质产生的电流汇集起来，以产生更大的输出电流，其与活性物质接触的越充分，内阻尽可能的小，则锂电池性能越好。得益于全球新能源汽车动力电池装机量持续增长、储能电池加速出货、3C 电池及人工智能、低空经济等未来新兴产业发展等因素影响，全球锂电池出货量保持较快增长，进一步拉动对锂电铜箔的强劲需求。据高工锂电（GGII）调研统计，我国 2024 年锂电铜箔出货量达到 69 万吨，同比增长 28.97%，预计到 2027 年我国锂电铜箔市场出货量将达 107 万吨，2024-2027 年复合增长率为 15.75%。

电子铜箔是现代电子工业与新能源领域不可或缺的关键基础材料，主要用于生产覆铜板（CCL）和印制电路板（PCB），其核心功能在于导电、导磁与储能。电子铜箔作为覆铜板的导电层，通过蚀刻工艺形成精密电路，充当电子元器件的连接载体，负责高效传输信号与电力，是电子设备运行的“神经网络”。应用范围广泛，涵盖日常消费类电子产品，以及 AI、5G 通信、数据中心等行业。Prismark 数据显示 2024 年全球 PCB 产值重启回升，同比增长 5%；2023-2028 年全球 PCB 产值预计年复合增长率达 5.4%，2028 年全球 PCB 产值将达到 904 亿美元，行业发展前景广阔。电子铜箔作为 PCB 的核心材料，也迎来市场增长机遇。根据中金企信国际咨询《2024-2030 年电子电路铜箔行业发展战略研究及市场占有率评估预测报告》统计，随着 PCB 等产业对电子电路铜箔需求的增长，2024 年、2025 年，电子电路铜箔的需求量分别为 43 万吨、45 万吨，预测到 2030 年中国电子电路铜箔出货量将达 53.80 万吨。

根据海关总署数据，2025年上半年，我国电子铜箔进口量为 39,464 吨，同比增长 1.36%；出口量为 22,059 吨，同比增长 9.31%，进出口规模持续扩大，但贸易仍呈显著逆差态势。价格方面，2025 年上半年，我国电子铜箔平均进口价格为 16,618 美元/吨，平均出口价格为 12,347 美元/吨，价差明显，反映出进口电子铜箔仍以高端产品为主。高端锂电铜箔市场长期被日韩企业主导，国内电池厂商对进口产品仍有较大依赖。然而，随着国产铜箔技术不断进步，进口替代进程正在加速推进。

铜箔行业属于国家鼓励和扶持的行业，国家一系列产业政策及指导性文件的推出，为公司所处行业的健康发展提供了良好的政策环境。《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》《铜产业高质量发展实施方案（2025—2027 年）》等文件提出要加快推广高强高导铜线缆、5G 基站用铜散热器、超低粗糙度铜箔、高精度铜齿轮等高端铜材，同时开展高端压延铜箔等高性能铜合金材料制备技术研发及产业化应用。《鼓

励外商投资产业目录（2022年版）》、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》、《产业结构调整指导目录（2024年本）》等文件，均将铜箔材料纳入鼓励类产业范围，不仅明确了其作为高性能关键基础材料的重要地位，还为行业发展指明了方向。《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》进一步将铜箔材料归类为“01 数字产品制造业”，凸显其在数字经济核心产业中的角色。工信部在《基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023年）》中明确提出加快发展高频高速、高密度、低损耗电子电路用铜箔，推动产业高端化转型。

综上所述，得益于新能源电动汽车、储能系统和电子信息技术的高速进步，以及5G、AI、云计算、大数据等应用场景扩大，加之政策的有力支持，铜箔市场需求呈现出增长的态势，高端产品市场潜力巨大。

## 2、半导体产业发展带来蚀刻引线框架需求增加

引线框架是一种借助于键合材料（金丝、铝丝、铜丝）实现半导体芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件，它起到和外部导线连接的桥梁作用，是电子信息产业中重要的基础材料之一。引线框架产品按照加工方法可划分为冲压引线框架和蚀刻引线框架两种类型。冲压引线框架主要通过使用模具靠机械力作用对金属材料进行冲切，形成复杂电路图案。冲压引线框架虽然生产成本较低，但加工精度较为有限，无法满足高密度封装的要求，因此，对于微细线宽与间距所用的引线框架通常只能通过蚀刻方法加工而成，主要采用光刻及溶解金属的化学试剂从金属条带上蚀刻出图案。半导体芯片广泛应用于集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明应用、大功率电源转换等领域应用。半导体是信息技术产业的核心以及支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其技术水平和发展规模是衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。

为了推动国内半导体产业的创新发展和打破国外技术垄断，实现半导体技术的自主可控，国家出台了一系列行业产业扶持政策。在国家“十四五”规划中，国家明确强调了集成电路的重要性，并注重集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料的研发，特别在“新型显示与战略性电子材料”重点专项中，第三代半导体被列为重点内容。此外，2020年国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，强调集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键

力量。该政策从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八大方面提出了具体措施，旨在进一步优化集成电路产业和软件产业的发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，为产业的持续健康发展提供了保障。

近年来，全球半导体市场规模总体呈增长态势。随着 5G 通信、人工智能、物联网、大数据等新兴技术的快速发展，对半导体芯片的需求持续攀升。根据 SEMI 的数据，2024 年全球半导体材料市场同比增长 3.8%，市场规模约 675 亿美元；其中，封装材料营收同比增长 4.7% 至 246 亿美元。近两年半导体行业在先进制程技术方面取得显著进步，芯片封测行业内部结构逐步向高端迈进，先进封装展现出比传统封装更强的增长势头。在 5G 通信领域，基站建设、5G 终端设备对高性能芯片需求巨大，推动了射频芯片、基带芯片等的发展；在人工智能领域，对算力的超高需求促使 GPU、TPU、NPU 等人工智能芯片市场迅速扩张；在物联网领域，海量的传感器、微控制器以及连接芯片需求，为半导体市场开辟了新的增长空间。这些新兴应用领域具有广阔的发展前景，将持续拉动半导体市场增长。

综上，我国半导体芯片产业正处于快速发展的阶段，由此带来了对引线框架材料的大量需求。

## （二）本次向特定对象发行股票的目的

### 1、增强公司铜箔业务生产能力，积极布局铜箔业务

规模化效应是铜箔行业发展的重要驱动力，一方面，随着产量的提升，相关成本费用得以有效摊薄，规模化效应可有效降低企业单位生产成本，从而提升竞争力；另一方面，铜箔下游主要客户为动力电池、储能电池及 PCB 生产厂家，其对铜箔供应商的供货能力与稳定性有较高要求，规模体量小的铜箔厂家很难进入优质客户供应链。

温州地区新能源产业已经初具规模：比亚迪温州弗迪新能源动力电池项目规划年产能 20GWh；瑞浦兰钧温州新能源制造基地（三期）项目（二阶段）已投产，达产后将形成 24GWh 的电芯制造产能，加上一期二期累计产能可达 50GWh。截至目前，温州地区尚无成规模锂电铜箔生产商。

国产高端电子铜箔市场存在较大供应缺口：2025 年上半年，我国电子铜箔进口量为 39,464 吨，同比增长 1.36%；出口量为 22,059 吨，同比增长 9.31%。价格方面，2025 年上半年，我国电子铜箔平均进口价格为 16,618 美元/吨，平均出口价格为 12,347 美元/

吨，反映出进口铜箔仍以高端产品为主。

通过募投项目的实施，公司将扩大生产能力，充分释放铜箔业务的规模效应，有效降低生产成本，提升供货规模和稳定性；有助于补齐温州地区锂电池产业链的关键环节，与上、下游客户形成紧密协同合作关系，对区域新能源产业链起到“强链、补链”的积极作用，增强公司综合竞争力。

## 2、扩大蚀刻引线框架产能，加强公司产品产业链的纵向延伸和技术协同

公司发展战略是深耕现有五大业务板块，力求在电接触复合材料领域保持领先地位，并在金属基功能复合材料、硬质合金材料、铜箔材料、蚀刻引线框架材料领域进一步扩大市场覆盖率，打造核心竞争力。作为公司战略的一部分，公司自 2021 年起进入电子材料领域，依托基于原有电接触复合材料的技术研发优势，实现了半导体蚀刻引线框架与电接触复合材料产业链的纵向延伸和技术协同。截至本预案公告日，公司控股子公司浙江宏丰半导体新材料有限公司一期已试生产，并具备小批量生产能力，相关产品已送下游客户试用。

国内蚀刻引线框架领域企业起步较晚，在高端蚀刻引线框架领域方面与境外主流厂商仍存在差距，国外厂商市场占有率较高，但国产高端蚀刻引线框架发展潜力较大。随着募投项目的实施，公司将逐步形成稳定的半导体蚀刻引线框架材料的供货能力，产品技术水平、产品种类丰富程度将显著提升，从而更好地满足客户需求，打造公司在半导体新材料领域的核心竞争力。

## 3、优化财务结构、降低财务费用

通过本次发行，有利于降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力；同时，可缓解公司为解决资金需求而通过债权融资的压力，有助于控制有息债务的规模，减少公司财务费用的支出，从而提高公司的经营业绩，也有利于维护公司中小股东的利益，降低经营风险，从而实现公司的战略目标。

# 三、发行对象及其与公司的关系

## （一）发行对象

本次向特定对象发行股票的对象不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机

构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式，按照统一价格认购公司本次发行的股票。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

## （二）发行对象与公司的关系

截至本预案公告日，公司本次向特定对象发行股票尚无确定的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中披露发行对象与公司的关系。

# 四、本次向特定对象发行股票的方案

## （一）本次发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

## （二）发行方式和发行时间

本次发行采取向特定对象发行的方式，公司将在深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会关于本次发行同意注册文件的有效期内选择适当时机实施。

## （三）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的对象不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司

董事会根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式，按照统一价格认购公司本次发行的股票。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

#### （四）发行数量

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前剔除库存股后的公司总股本的 30%，即不超过 149,093,466 股（含本数）。最终发行数量由公司股东会授权董事会及其授权人士根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次董事会决议公告日至发行期间发生派发股利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致发行前公司总股本减去库存股的数量发生变动的，则本次发行数量上限进行相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

#### （五）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由董事会根据股东会的授权，和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

派发现金同时送红股或转增股本： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， $P_0$ 为调整前发行底价， $D$ 为每股派发现金股利， $N$ 为每股送红股或转增股本数量，调整后发行底价为 $P_1$ 。

## （六）限售期安排

本次向特定对象发行完成后，特定对象所认购的股份限售期需符合《上市公司证券发行注册管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定，本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让。限售期结束后减持按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行对象所取得上市公司的股份因上市公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。

## （七）募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 45,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元				
序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	实施主体
1	锂电铜箔及电子铜箔扩产项目	28,000.00	28,000.00	浙江宏丰铜箔有限公司
2	半导体蚀刻引线框架项目	17,000.00	17,000.00	浙江宏丰半导体新材料有限公司
合计		45,000.00	45,000.00	-

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

## （八）上市地点

本次发行的股票拟在深交所创业板上市交易。

### **(九) 本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排**

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后公司的新老股东按照其持股比例共同享有。

### **(十) 本次发行决议有效期**

本次发行的决议自公司股东会审议通过本次发行方案之日起 12 个月内有效。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

## **五、本次发行是否构成关联交易**

截至本预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

## **六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化**

截至 2025 年 12 月 31 日，陈晓直接持有公司 156,138,612 股股份，占公司股本的 31.42%，为公司控股股东；林萍直接持有 15,444,000 股股份，占公司股本的 3.11%；陈晓和林萍为夫妻关系，合计持有公司 171,582,612 股股份，占公司股本的 34.53%，共同构成公司的实际控制人。

按照本次发行上限 149,093,466 股测算，假设公司实际控制人陈晓、林萍不认购本次发行的股份，本次发行完成后公司实际控制人陈晓、林萍持有公司股本比例为 26.56%，仍为公司实际控制人。

因此，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。

## **七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序**

本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第六届董事会第八次（临时）会议审议通过。本次向特定对象发行股票方案尚需公司股东会审议、深交所审核通过和中国证监会对本次向特定对象发行作出同意注册决定后方可实施。

在完成上述审批手续之后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

上述呈报事项能否获得同意注册，以及获得同意注册的时间，均存在不确定性。提请广大投资者注意审批风险。

## **八、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件**

本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

## 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

### 一、本次募集资金使用投资计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 45,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元				
序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	实施主体
1	锂电铜箔及电子铜箔扩产项目	28,000.00	28,000.00	浙江宏丰铜箔有限公司
2	半导体蚀刻引线框架项目	17,000.00	17,000.00	浙江宏丰半导体新材料有限公司
合计		45,000.00	45,000.00	-

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

### 二、本次募集资金投资项目的具体情况

#### （一）锂电铜箔及电子铜箔扩产项目

##### 1、项目概况

项目名称	锂电铜箔及电子铜箔扩产项目
实施主体	浙江宏丰铜箔有限公司
项目总投资	28,000.00 万元
项目建设内容	本项目拟建成 6 条锂电铜箔生产线、2 条电子铜箔生产线。
项目建设地点	温州市温州海洋经济发展示范区昆鹏街道远堤路 138 号

##### 2、项目投资概算

本项目总投资金额为 28,000.00 万元，拟使用募集资金 28,000.00 万元。本项目建设投资估算如下：

序号	费用名称	金额(万元)	占比
1	设备购置费	24,955.00	89.13%
2	安装工程费	545.00	1.95%
3	流动资金	2,500.00	8.93%
合计		28,000.00	100.00%

### 3、项目建设的必要性

#### (1) 符合公司发展战略，创造新的利润增长点

铜箔项目作为公司战略规划中的重要组成部分，目前正处于产能爬坡和市场深度开发阶段，各项工作正按计划稳步推进，营收规模、客户群体持续扩大。本项目的实施将进一步加快铜箔业务技术研发与产能提升的进程，延伸高附加值产品链条，与现有业务形成战略协同效应，进一步提升公司在高端铜箔领域的规模化供应能力和市场话语权，强化公司整体竞争力，为公司中长期发展注入新动力，并为股东及投资者带来持续且稳定的价值回报。

#### (2) 提升规模化效应

规模化效应是铜箔行业发展的重要驱动力，一方面，随着产量的提升，相关成本费用得以有效摊薄，规模化效应可有效降低企业单位生产成本，从而提升竞争力；另一方面，铜箔下游主要客户为动力电池、储能电池及 PCB 生产厂家，其对铜箔供应商的供货能力与稳定性有较高要求，规模体量小的铜箔厂家很难进入优质客户供应链。

截至目前，公司铜箔产能为 10,000 吨，虽然近几年公司铜箔业务产销量逐步提升，但由于规模化效应不强，大客户验证周期较长，公司的铜箔业务销售规模整体较小。通过本项目的实施，公司将扩大生产能力，充分释放铜箔业务的规模效应，有效降低生产成本，提升供货规模和稳定性，更好满足下游客户对供应商的要求。

#### (3) 补足地区新能源产业链

温州地区新能源产业已经初具规模。比亚迪温州弗迪新能源动力电池项目规划年产能 20GWh。此外，瑞浦兰钧温州新能源制造基地（三期）项目（二阶段）已投产。达产后将形成 24GWh 的电芯制造产能，加上一期二期累计产能可达 50GWh。

大客户通常对原材料供应的稳定性和及时性有较高要求，截至目前，温州地区尚无成规模锂电铜箔生产商，上述新能源电池项目所需的锂电铜箔大部分从温州地区外采购，导致其运输成本较高。本项目的建立实质上构建起了一条敏捷响应、安全可控的近地供应链体系，可实现对核心客户的及时供应、大幅降低其物流与库存成本，并强化产业链协同效率，有助于公司深度嵌入大客户供应链体系，由供应商升级为战略合作伙伴。

本募投项目的实施，有助于促进公司和上述公司的业务合作，补齐温州地区锂电池产业链的关键环节，与上、下游客户形成紧密协作关系，对温州地区新能源产业链具有“强链、补链”的积极作用，创造区域产业协同效应独特优势。

## 4、项目建设的可行性

### （1）符合国家政策支持

铜箔行业属于国家鼓励和扶持的行业，国家一系列产业政策及指导性文件的推出，为公司所处行业的健康发展提供了良好的政策环境。《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》《铜产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》等文件提出要加快推广高强高导铜线缆、5G基站用铜散热器、超低粗糙度铜箔、高精度铜齿轮等高端铜材，同时开展高端压延铜箔等高性能铜合金材料制备技术研发及产业化应用。《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》等文件，均将铜箔材料纳入鼓励类产业范围，不仅明确了其作为高性能关键基础材料的重要地位，还为行业发展指明了方向。《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》进一步将铜箔材料归类为“01 数字产品制造业”，凸显其在数字经济核心产业中的角色。工信部在《基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023年）》中明确提出加快发展高频高速、高密度、低损耗电子电路用铜箔，推动产业高端化转型。

在下游应用领域，我国相继出台多项政策，支持新能源和PCB行业的发展。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》《“十四五”现代能源体系规划》《“十四五”新型储能发展实施方案》《产业结构调整指导目录（2024年本）》以及《促进汽车动力电池产业发展行动方案》等一系列政策，均强调了新能源汽车、储能、锂电池等行业的重点支持地位。《国家重点支持的高新技术领域目录》《鼓励进口技术和产品目录》《产业结构调整指导目录》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等政策方针，把PCB行业相关产品列为重点发展对象；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十

四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备，核心电子元器件、关键软件等产业水平。

## （2）行业市场空间大

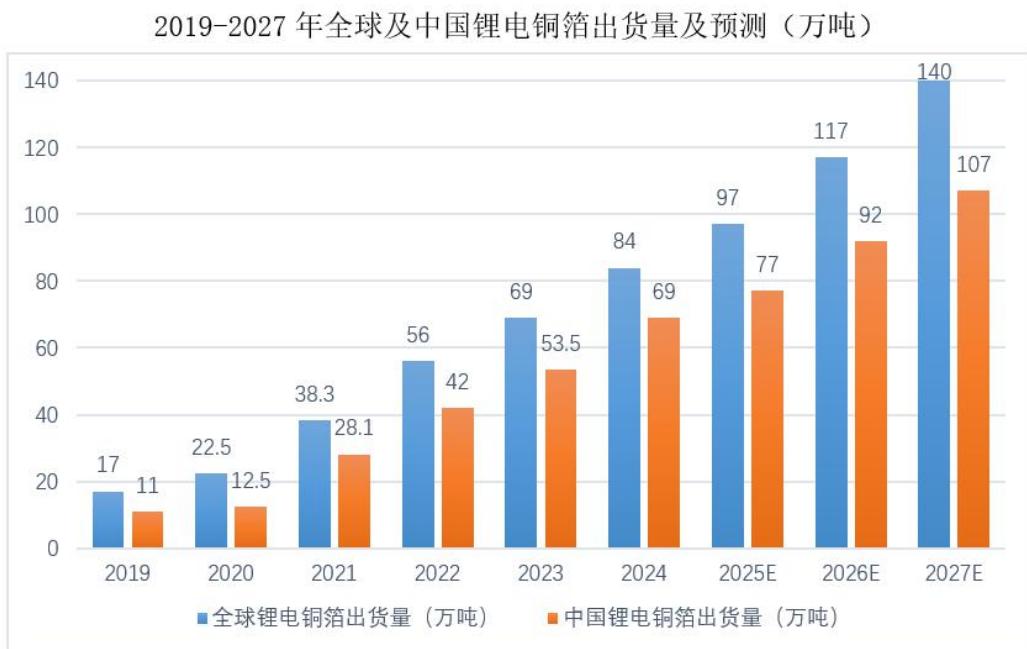
### 1) 锂电铜箔的市场情况

随着全球新能源汽车渗透率快速提升和储能市场需求爆发，锂电池产业持续高速增长，带动其关键材料锂电铜箔需求稳步攀升。作为电池负极集流体的关键材料，锂电铜箔不仅承担着活性物质的载体功能，更是电子收集与传导的关键介质，其性能直接影响电池的能量密度、循环寿命和内阻表现，铜箔与负极材料接触越充分、导电性越优异，则电池整体性能越佳。

凭借优异的导电性、良好的延展性、成熟的制造工艺以及显著的成本优势，锂电铜箔已成为当前锂电池负极集流体的首选材料。其中，4-6 微米极薄铜箔因有助于提升电池能量密度、减轻重量并节约空间，正逐步成为高能量密度动力电池的技术主流。公司聚焦于高性能极薄锂电铜箔的研发与生产，精准契合下游电池技术向轻量化、高能效方向发展的核心需求。

根据 EVTANK 统计及预测，2024 年全球锂电池出货量持续上升至 1,545.1GWh，同比增长 28.5%；2030 年全球锂电池出货量预计达 5,127.3GWh，2024-2030 年复合增长率达 22.1%；根据 GGII 统计及预测，2024 年我国锂电池出货量达 1,175GWh，2020-2024 年复合增长率达 69%；2027 年中国锂电池出货量预计达 2,031GWh，2024-2027 年复合增长率仍将保持在 20% 左右。

据高工锂电（GGII）调研统计，2024 年全球锂电铜箔出货量达 84 万吨，同比增长 21.74%；中国锂电铜箔出货量达到 69 万吨，同比增长 28.97%。GGII 预计到 2027 年全球锂电铜箔市场出货量将达 140 万吨，2024-2027 年复合增长率为 18.56%，2027 年中国锂电铜箔市场出货量将达 107 万吨，2024-2027 年复合增长率为 15.75%，展现出强劲的增长潜力。

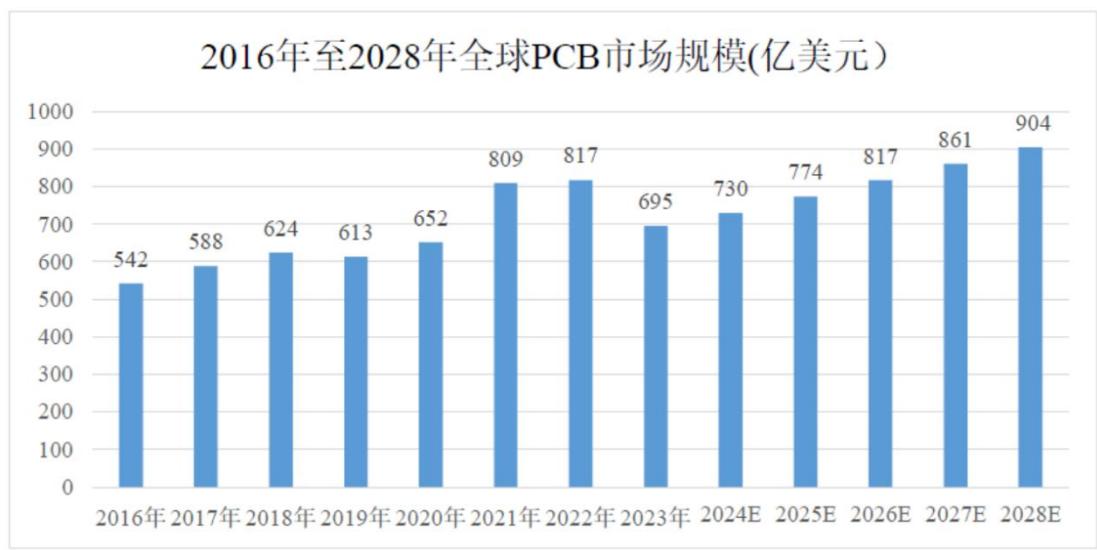


数据来源：高工锂电（GGII）

2) 受益于全球 PCB 市场景气度稳步回升，电子电路铜箔市场规模持续提升

电子电路铜箔的直接下游行业为覆铜板行业。覆铜板是指将电子布等作增强材料，浸以树脂，单面或双面覆以铜箔，经热压而成的一种板状材料，是用于加工制造 PCB 的核心基础材料。电子电路铜箔作为覆铜板（CCL）和印制电路板（PCB）的关键基础材料，广泛应用于 5G 通信、消费电子、汽车电子、通讯雷达、AI 服务器等领域。其一面光亮、一面粗糙的结构设计，确保了与基材的良好结合力及电路信号传输的高效性。随着 5G 基站大规模建设、数据中心扩容和汽车电子化程度提高，高性能 PCB 标箔需求持续上升。

2024 年以来，随着终端库存压力逐渐缓解以及下游消费需求回暖，PCB 行业整体景气度有所回暖。AI 服务器及数据存储、高频通信和汽车系统持续强劲的需求将持续支持 PCB 产业链中高端 HDI、高速高频和封装基板等细分市场的快速增长，并为 PCB 行业带来新一轮成长周期，未来全球 PCB 行业仍将呈现持续向好的趋势。Prismark 数据显示 2024 年全球 PCB 产值重启回升，同比增长 5%；2023-2028 年全球 PCB 产值预计年复合增长率达 5.4%，2028 年全球 PCB 产值将达到 904 亿美元，行业发展前景广阔。



数据来源：Prismark

在此背景下，作为 PCB 核心原材料之一的电子电路铜箔也迎来需求上升期。根据中企信国际咨询《2024-2030 年电子电路铜箔行业发展战略研究及市场占有率评估预测报告》统计，随着 PCB 等产业对电子电路铜箔需求的增长，2024 年、2025 年，电子电路铜箔的需求量分别为 43 万吨、45 万吨，预测到 2030 年中国电子电路铜箔出货量将达 53.80 万吨。

### （3）现有技术储备为项目实施提供坚实基础

作为国内电接触功能复合材料领域的领军企业，公司多年来深耕于金属材料微观结构调控与精密加工工艺，形成了深厚的技术壁垒。这些核心能力在晶粒取向控制、表面界面处理等关键环节与高端铜箔制造具有显著的技术协同性。公司配置了国际一流设备厂商的成套高端产线，可满足高性能铜箔生产要求。随着生产经验的不断积累和工艺的持续优化，产品良率和关键性能指标有望实现阶梯式提升。

铜箔作为新能源电池与高端电子器件的关键基础材料，其质量一致性直接决定终端产品的安全性与效能。公司依托在电接触材料领域深耕多年所积累的质量管控经验，构建了覆盖全生命周期的精细化质量管理体系：从原材料筛选、制程参数实时监控到成品性能验证，实现全链条数字化与标准化管控，确保高端铜箔产品的批次稳定性与可靠性达到行业领先水平。优异的质量管控能力不仅是公司技术可行性的重要组成部分，也是获得高端客户认可的基础。

在技术布局方面，浙江宏丰铜箔拥有授权专利 7 项，另有 6 项专利正在申请中，覆

盖铜箔生产工艺、产品性能等多个关键技术领域。此外，浙江宏丰铜箔与浙江工业大学共建“先进铜箔材料联合研发中心”，聚焦锂电铜箔添加剂研发、表面处理工艺优化及5G铜箔工艺开发，这一产学研合作机制为公司提供了高校科研力量支持；公司投资1000万元设立全资子公司“温州宏丰新材料研究院有限公司”，构建了“研发—中试—产业化”全链条创新体系，布局高性能极薄锂电铜箔、固态电池用铜箔、PCB用高端电子电路铜箔等领域，为公司持续创新提供坚实的制度保障。

在人才队伍建设方面，公司通过内部培养和外部引进相结合的方式，组建了一支专业的铜箔研发与生产团队，核心技术人员在铜箔生产及应用领域具备深厚经验，能够迅速响应和解决生产过程中的技术问题。人才队伍的持续壮大和结构优化，为公司的技术攻关与创新发展提供了强有力的智力支持。

#### **(4) 公司铜箔生产能力初具规模，客户资源储备丰富**

自公司2022年进入铜箔行业以来，至2025年年底，已顺利完成锂电铜箔一期项目的建设，成功构建了1万吨的产能规模。一期项目的实施，为公司在锂电铜箔行业积累了丰富的生产经验和客户资源。从2022年至2024年，公司铜箔业务收入逐年增长，分别为760.27万元、7,237.66万元和15,862.50万元，呈稳步上升的趋势。公司与动力电池、储能电池和消费电子等多个领域客户等建立了稳固的合作关系，并顺利通过了瑞浦兰钧的供应商认证。一期项目积累的技术储备、生产经验和客户资源，为本项目的开展提供了坚实的保障。

### **5、项目经济效益分析**

经测算，本项目达产后，预计年销售收入125,970.43万元，年利润总额4,336.68万元，财务内部收益率（税后）为11.38%。

### **6、项目审批情况**

#### **(1) 项目批复或备案情况**

截至本预案公告之日，本项目备案手续尚在进行中。

#### **(2) 环保审批情况**

截至本预案公告之日，本项目环保审批手续尚在进行中。

#### **(二) 半导体蚀刻引线框架项目**

## 1、项目概况

项目名称	半导体蚀刻引线框架项目
实施主体	浙江宏丰半导体新材料有限公司
项目总投资	17,000 万元
项目建设内容	本项目将建设两条镀银引线框架生产线及一条镀金引线框架生产线，达产后将形成半导体蚀刻引线框架年产能约 1,176 万条。
项目建设地点	浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道海鸥路 500 号

## 2、项目投资概算

本项目总投资金额为 17,000.00 万元，拟使用募集资金 17,000.00 万元。本项目建设投资估算如下：

序号	费用名称	金额 (万元)	占比
1	设备购置费	14,505.00	85.32%
2	安装工程费	595.00	3.50%
3	流动资金	1,900.00	11.18%
合计		17,000.00	100.00%

## 3、项目建设的必要性

### (1) 满足市场需求增长

蚀刻引线框架是先进半导体封装的核心载体材料。在封装材料市场格局中，引线框架以约 15% 的市场份额稳居第二大材料品类，仅次于有机基板。其中，蚀刻工艺凭借微细化加工优势，成为超薄型、高引脚密度引线框架的主流制备方案，特别适用于 QFN/DFN 等高密度集成电路封装场景。虽然目前冲压引线框架应用范围更广，2024 年市场占比高达 67.9%，但蚀刻引线框架凭借  $\pm 5 \mu\text{m}$  级高精度和  $50 \mu\text{m}$  以下超薄成型能力，在 SiP 系统级封装、2.5D/3D 先进封装领域的需求持续增长，当前处于产能紧缺状态。随着终端电子产品持续向轻薄化、高集成度演进，以及人工智能算力芯片、5G 射频模组、车规级功率器件、物联网传感器等新兴应用对半导体器件高性能、高可靠性、微型化的严苛要求，蚀刻引线框架的技术重要性愈发凸显。预计全球半导体引线框架市场将保持快速增速，其中蚀刻工艺占比将持续提升。

根据 SEMI 的数据，2024 年全球半导体材料市场同比增长 3.8%，市场规模约 675 亿美元；其中，封装材料营收同比增长 4.7% 至 246 亿美元。根据 QYResearch 调研，

2024年全球引线框架市场销售额达到42.95亿美元，预计2031年将达到55.41亿美元，2025-2031期间年复合增长率（CAGR）为3.8%。

近年来，随着我国封测产业规模不断扩大，长电科技、华天科技、通富微电等均已进入全球封测业十强，且仍在继续扩张中，在国家鼓励半导体材料国产化政策的影响下，国内对引线框架产品的需求将会持续增加。根据观研天下数据，2023年我国半导体引线框架行业市场规模约为123.2亿元，同比增长7.3%。随着国内整体半导体国产化替代需求持续推动，我国引线框架市场规模将持续向好。

### **（2）国内高端产品替代潜力较大**

国内蚀刻引线框架领域企业起步较晚，经过多年发展已取得巨大进步，但在高端蚀刻引线框架领域与境外主流厂商仍存在差距。根据集微咨询统计数据，全球前八大引线框架企业占据约62%的市场份额，其中日本三井、长华科技（中国台湾）和日本新光为全球前三大引线框架厂商，分别占据12%、11%和9%的市场份额。高端蚀刻引线框架领域，中国大陆生产厂商基础较为薄弱，仅有康强电子、新恒汇及天水华洋电子科技股份有限公司等少数企业可以批量供货，国产高端蚀刻引线框架未来发展空间广阔。

### **（3）符合公司发展战略，提升企业竞争力**

公司一直秉持“专注主业、延伸产业链、扩大应用领域”的发展理念。作为公司战略规划的落地措施之一，半导体蚀刻引线框架项目的实施可进一步丰富公司的产品链，提升产品技术水平，优化产品结构，满足客户高端需求，强化综合实力和差异化优势，有利于提升公司的核心竞争力。

## **4、项目建设的可行性**

### **（1）符合国家政策支持**

国家高度重视半导体产业的发展，出台了一系列支持政策，半导体行业的发展促进了上游电子材料产业的协同发展。

2020年，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，国家鼓励的集成电路材料、封装、测试企业给予财税、投融资、研发、进出口、人才、知识产权等方面优惠的政策。

2020年，财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合发布《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》，国家鼓励的集成电路材

料、封装、测试企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

2020 年，发改委、科技部、工信部、财政部联合发布《关于扩大力发展战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》（发改高技〔2020〕1409 号），文件明确了聚焦重点产业投资领域，加快在包括电子封装材料在内的多个领域实现突破。

2021 年 12 月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，强调要增强关键技术创新能力，瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路等战略性前瞻性领域，提高数字技术基础研发能力。完善 5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。

2024 年 1 月，工业和信息化部等七部门联合制定《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出要推动有色金属、先进半导体等关键战略材料发展，加快超导材料等前沿新材料创新应用。

2024 年 3 月，市场监督管理总局、中央网信办等部门联合制定《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024-2025 年）》，明确在集成电路、半导体材料等关键领域集中攻关，加快研制一批重要技术标准。

2025 年 8 月，工业和信息化部、市场监督管理总局发布了《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》（工信部联电子〔2025〕181 号），通过国家重点研发计划相关领域重点专项，持续支持集成电路、先进计算、未来显示、新型工业控制系统等领域科技创新。

上述政策和法规的发布落实，为半导体行业提供了财政、税收、技术和人才等多方面的支持，促进了半导体行业的发展，加快了半导体产业的国产化进程。公司建设半导体蚀刻引线框架项目，属于国家政策明确鼓励的先进半导体材料和关键工艺领域，具备坚实的政策支持基础和良好的发展环境。

## （2）公司具备工艺技术

引线框架的生产过程需要根据所封装芯片的面积、厚度、功能、引脚布局，相对应的设计出线宽及线距为最小 50 微米的精细电路图案。封装好的芯片在工作时，要通过引线框架的线路与外部其他电子部件进行电信号通讯，以实现芯片的特定功能。引线框架的生产需要在约 0.1 毫米厚度的金属铜合金原材料上，根据设计好的电路图案进行高

精度的蚀刻加工。通常采用的技术是利用光刻法，将设计图案转印到金属表面的感光膜上，再通过显影与蚀刻工艺，最终形成所需要的图案。由于刻蚀图案的精度要求非常高，高精度铜箔的表面须具备非常高的洁净度，生产过程中任何尘埃的残留等都可能导致不良品产生，因此引线框架的生产必须在千级洁净车间内进行。

公司在电接触材料领域积累了丰富的材料配方、精密加工和表面处理经验，可为蚀刻引线框架的工艺开发提供关键技术支撑，尤其在材料性能调控、精加工及质量一致性控制方面具备共通性。依据公司发展战略，基于原有电接触复合材料的技术研发优势，自2021年起公司正式进入半导体蚀刻引线框架领域。通过自主研发，公司实现了半导体蚀刻引线框架与电接触复合材料的研发与生产产业链的纵向延伸和技术协同，掌握了多项蚀刻引线框架技术工艺。

卷对卷连续高精度图案蚀刻技术，可以实现在整卷400米卷材上的连续生产，同时将图案蚀刻精度控制在15微米以内。这不仅保证了连续生产中的速度与对位控制精度，还有效避免了因曝光不足或者过度、蚀刻不足或者过度等问题导致的精细电路出现偏移、变形、断线或粘连等质量缺陷。

公司将卷式无掩膜激光直写曝光（LDI）生产技术成功应用到蚀刻引线框架的生产过程中。相比于传统曝光方式，卷式无掩膜激光直写曝光技术具有显著优势：一方面，生产过程中不需要委托加工高精度掩膜版，不仅有效提升了生产效率，缩短了产品生产和交付周期，同时也避免了环境尘埃落在掩膜版上造成的不良隐患；另一方面，通过激光直接成像曝光后的蚀刻引线框架产品，其图像解析度更高，可达到20微米，在行业内处于领先水平。

公司金属表面处理相关技术在业内处于领先地位。在完成高精度图案蚀刻加工后，须对引线框架产品的表面进行复杂的表面处理，使产品能够满足封装或者使用中所要求的特性，主要包括较高的可焊接性、较强的抗腐蚀能力、耐插拔性等。公司成功研发了无模具选择性电镀技术，相较于传统的模具遮蔽选择性电镀技术，该技术具有低成本、快交期、高精度的明显优势。

截至本预案公告日，公司引线框架材料生产基地一期已试生产，实现小批量供货，相关产品已送下游客户试用，通过客户的试用验证后，产品可进入客户的供应链体系。

公司不断加大对电子材料的技术投入和研发力度，本项目的建成并达产，有利于公司在日益激烈的市场竞争环境下提升公司的综合服务能力和水平，扩大生产经营规模和业务渠道，提升产品技术水平，增强公司盈利能力，符合公司战略发展的需要。

## 5、项目经济效益分析

经测算，本项目达产后，预计年销售收入 16,990.59 万元，年利润总额 2,145.70 万元，财务内部收益率（税后）为 9.11%。

## 6、项目审批情况

### （1）项目批复或备案情况

截至本预案公告之日，本项目备案手续尚在进行中。

### （2）环保审批情况

截至本预案公告之日，本项目环保审批手续尚在进行中。

## 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

### （一）本次发行募集资金投资项目对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目有利于进一步提升公司综合竞争力，持续优化公司主营业务结构，夯实产品市场竞争力，有效提升公司经营管理能力，进而提升公司盈利水平，增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

### （二）本次发行募集资金投资项目对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产的规模均将有所增加，进一步提高公司抗风险的能力，为公司未来的发展奠定基础。同时，本次发行有利于优化公司的资产负债结构，增强公司偿债能力与抗风险能力，公司的财务结构将更加稳健。

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将有所增加，在资金开始投入募集资金投资项目后，公司投资活动产生的现金流出也将相应增加。未来，随着募集资金投资项目的实施和效益产生，公司的竞争实力将不断提升，公司经营活动产生的现金流量预计将进一一步增加。

本次发行完成后，公司股本总额、资产总额及资产净额将在短期内快速增加，但由于募集资金投资项目具有一定的建设周期，募集资金使用至产生效益需要一定时间，因此公司每股收益、净资产收益率等指标在短期内会出现一定程度的摊薄。从中长期来看，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司业务规模得以进一步扩大，有助于公司提升市场地位与核心竞争力，进而对公司的可持续发展能力和盈利能力起到良好的促进作用。

#### 四、本次募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，本次募集资金使用用途符合未来公司整体战略发展规划，以及相关政策和法律法规，具备必要性和可行性。本次募集资金投资项目的实施，有利于提升公司整体竞争实力，增强公司可持续发展能力，为公司发展战略目标的实现奠定基础，符合公司及全体股东的利益。

### 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

#### 一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响

##### （一）本次发行对公司业务及资产的影响

本次向特定对象发行股票募集资金总额在扣除费用后将投资于锂电铜箔及电子铜箔扩产项目、半导体蚀刻引线框架项目。上述项目紧密围绕公司主营业务、迎合市场需求、顺应公司发展战略，系对公司主营业务的升级和拓展。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，不涉及对公司现有资产的整合，不会对公司的业务及资产产生重大影响。

##### （二）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司的股本将相应增加，股东结构也将相应发生变化。公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。

##### （三）发行后上市公司股东结构变动情况

本次发行完成后，公司的股本规模、股东结构及持股比例将发生变化，本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布仍符合上市条件。

##### （四）本次发行对高级管理人员结构的影响

本次发行完成后，公司不会因本次发行而调整公司的高管人员。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

##### （五）本次发行对业务结构的影响

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目系公司对主营业务、产品的拓展和完善，项目实施后将增强公司主营业务的盈利能力，不会导致公司业务结构发生重大变化。

#### 二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

##### （一）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产均将有较大幅度的提高，公司资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障；公司的资产负债率将显著降低，资产结构将更加稳健，有利于减少财务费用，降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。

## （二）对公司盈利能力的影响

本次发行后，公司股本总额将增加，短期内将可能导致公司净资产收益率、每股收益等指标一定程度的摊薄。但募集资金到位将有助于优化本公司资本结构、降低公司财务费用、增强资金实力，为公司进一步扩大经营规模、持续推进发展战略提供有力的资金支持，从而逐步提升公司的盈利能力。

## （三）对公司现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，并有效缓解公司日益增长的日常营运资金需求所致的现金流压力，有利于公司经营规模扩大，相应提升未来经营活动现金流入，公司总体现金流状况将得到进一步优化。

## 三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争的变化情况

本次募集资金投资项目“锂电铜箔及电子铜箔扩产项目”“半导体蚀刻引线框架项目”，拟分别由浙江宏丰铜箔有限公司、浙江宏丰半导体新材料有限公司实施。上述实施主体为上市公司控股子公司。

公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争情况均不会因本次发行而发生变化；本次发行不会增加公司与控股股东、实际控制人及其关联人间的关联交易及同业竞争。

## 四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

截至本预案公告日，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东及其关联人提供担保的情形。公司不会因本次发行产生资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不会产生为控股股东及其关联人提供担保的情形。

## 五、本次发行对公司负债情况的影响

本次发行完成后，公司的资产负债率将有所下降，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。公司的资产负债结构将更趋合理，抵御风险能力将进一步增强，符合公司全体股东的利益。

## 六、本次股票发行相关的风险说明

### （一）政策和市场风险

#### 1、宏观经济波动风险

近几年，国际政治经济形势复杂多变导致全球供应链不稳定，再加上全球通货膨胀问题，导致发达国家经济增长滞胀，新兴国家增长势头放缓，宏观经济变动的不确定性增强。未来，若国内外经济增速持续放缓甚至衰退，可能导致固定资产投资、基础设施建设的投资规模下降，进一步导致公司下游行业市场需求萎缩，将对公司的经营业绩产生不利影响。

#### 2、政策风险

公司主要产品应用的下游市场包括新能源汽车、储能、智能家电、传感器、半导体芯片等行业，受国家及行业产业政策支持等因素影响。公司产品下游市场的景气程度对公司业务发展有重要影响，如果未来国家行业产业政策发生不利变化，导致市场需求下降、政策支持力度减弱等变化，将对公司生产经营产生不利影响。

此外，公司产品远销海外，由于全球宏观经济波动频繁，国际贸易保护主义抬头，若对应国家的进出口政策、贸易政策等发生不利变动，可能对公司海外业务的持续、平稳发展带来风险。

#### 3、行业竞争加剧风险

公司所处的材料加工行业为完全市场化竞争的行业，国内外竞争对手众多，行业集中度不高，公司面临的行业竞争激烈。近几年，公司积极拓展产品线及其应用领域，提升自身核心竞争力。然而，若未来行业竞争进一步加剧，公司未能通过持续研发新产品和开发新客户来维持较高的销售规模、保持自身市场地位，公司经营状况和业绩情况可能存在不利变动的风险。

### （二）财务风险

## 1、原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料中白银、铜占比较高，报告期内，白银、铜的采购金额占公司原材料采购金额的比例分别为 82.39%、87.09%、83.64%、81.43%。白银、铜等主要原材料价格波动将对公司的盈利能力产生较大影响。

## 2、应收账款风险

报告期各期末，公司合并报表应收账款账面价值分别为 31,125.16 万元、36,319.30 万元、39,578.97 万元和 46,300.73 万元，占总资产的比例分别为 12.62%、12.72%、12.42% 和 13.00%。最近三年末，公司应收账款金额逐年上涨，主要系主营规模扩大所致，公司应收账款账龄较短，公司对主要客户信用政策未发生变化。公司根据行业特征、客户特点和收款情况制定了合理的坏账准备计提政策，对应收账款计提了相应的坏账准备。由于应收账款数额较大，一旦发生坏账损失不能收回，对公司的资产质量及财务状况将产生不利影响。

## 3、存货风险

报告期各期末，公司存货的账面价值分别为 74,814.99 万元、76,514.52 万元、81,275.94 万元和 83,475.39 万元，存货逐年增长，主要系业务扩张，进而采购量、生产量增加较多所致；公司对存货进行了减值测试，各期末存货跌价准备金额为 1,474.41 万元、2,344.05 万元、3,331.82 万元和 1,290.88 万元，占各期末存货余额的比例分别为 1.93%、2.97%、3.94% 和 1.55%。随着未来公司生产规模进一步扩张，公司的存货可能进一步增加，如果下游客户销售不畅或原材料价格发生大幅单边下跌，则公司可能会面临跌价损失的风险，从而对公司的经营业绩产生影响。

## 4、业绩波动的风险

报告期公司归属于母公司所有者的净利润分别为 3,032.57 万元、2,112.07 万元、-7,367.39 万元和 1,178.86 万元；公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 1,459.93 万元、-5,826.09 万元、-7,785.71 万元和 504.16 万元，报告期内公司盈利能力波动较大。随着公司铜箔业务的产能释放，公司未来的业绩有望提升。但如果未来市场竞争加剧，或业务开拓不及预期，公司存在业绩波动的风险。

## 5、经营性现金流的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-12,824.51 万元、-2,761.59 万

元、-5,215.03万元和491.68万元，流动资金较为紧张。虽然公司通过采用优化客户结构、协商缩短账期、申请提前结算应收款、开展供应链金融、提高存货管理效率等多种措施改善经营活动现金流情况，但若公司上述改善措施成效不佳，经营活动现金流相对紧张的状况在短期内仍将持续，公司存在经营活动现金流紧张的风险。

### **(三) 经营管理风险**

#### **1、业务规模扩大带来的管理风险**

随着公司业务的持续发展，公司经营规模不断扩大。本次发行后，随着募集资金的到位和投资项目的实施，公司总体经营规模将进一步扩大。这要求公司继续完善管理体系和制度、健全激励与约束机制，并加强执行力度。如果公司管理层不能合理构建适合公司实际情况的管理体制、或未能很好把握调整时机、或相应职位管理人员的选任出现失误，都将可能阻碍公司业务的正常推进，甚至错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。

#### **2、技术泄密的风险**

公司所处行业是涉及多门学科的高技术产业，是技术密集型行业。新技术、新工艺和新产品的开发和改进，是本公司赢得市场的关键。近年来，公司取得了丰硕的研发成果，其中多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了法律保护，并有多项研发成果正处于专利申请阶段。但是还有部分研发成果和工艺诀窍是公司多年来积累的非专利技术，如果该等研发成果失密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。

#### **3、客户集中的风险**

报告期内，公司对前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例为52.98%、48.53%、51.14%和49.37%，其中对正泰电器及其子公司的销售收入占当期营业收入的35.26%、29.54%、30.05%和27.93%。如果公司与主要客户的合作出现问题，或者公司主要客户的生产经营情况发生变化，有可能给公司的正常经营带来风险。

#### **4、技术创新的风险**

公司产品需按照客户产品特征和订单要求进行定制研发、设计和生产，迅速将客户的特定产品理念转化为可靠性高、可实施性强的设计方案和生产方案，是公司在激烈的行业竞争中生存与发展的关键所在。随着终端产品技术更新换代频率加快，下游行业产品不断呈现出高精度、高性能、智能化等趋势，从而对公司研发技术和生产工

艺提出了更高的要求。如果公司无法持续开发出符合客户需求的产品，或面对下游行业需求波动时无法采取适当的应对策略，将对公司的市场开拓构成不利影响，从而对公司经营业绩造成一定的不利影响。

如果公司的技术创新速度无法持续匹配客户个性化要求，或者公司的技术创新水平无法跟上行业进步的速度，则公司的核心技术将逐渐失去竞争力，进而面临被国内外市场上其他技术替代甚至淘汰的风险。

#### **(四) 本次发行相关风险**

##### **1、募集资金投资项目风险**

公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目的可行性分析，是基于当前市场环境、行业发展趋势等因素综合考量的结果。尽管投资项目已经经过慎重且充分的可行性研究论证，但由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间。在此期间，宏观政策环境的变动、行业竞争情况的演变、技术水平的重大更替、市场容量的不利变化等因素，都会对募集资金投资项目的实施产生较大影响。此外，在项目推进过程中，若发生募集资金未能按时到位、实施进度遭遇延期等不确定性事项，也会对募集资金投资项目的预期效益带来较大影响。

##### **2、即期回报被摊薄的风险**

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和归属于母公司所有者权益会有一定幅度增加，有助于改善公司资本结构。而募集资金的使用和产生效益需要一定的周期，短期内公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

##### **3、审批风险**

本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深交所审核通过和中国证监会同意注册，能否通过上述程序，以及最终取得注册的时间、获得注册的发行方案存在不确定性，特此提醒投资者关注相关审批风险。

## 第四节 公司利润分配政策及执行情况

### 一、公司现行的利润分配政策

根据《公司章程》，公司利润分配政策如下：

#### （一）利润分配原则

公司的利润分配应重视对社会公众股股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定，公司的利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，公司优先采用现金分红的利润分配方式。

#### （二）利润分配方式

公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。

#### （三）现金分红的条件

- 1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3、预期实施现金分红后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要；
- 4、公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

#### （四）现金分红的比例

公司应保持利润分配的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 3000 万元；

2、公司未来十二个月内拟进行对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

具体每个年度的分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，由公司股东会审议决定。

#### （五）现金分红的期间间隔

在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

#### （六）股票股利分配的条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益，具体分配方案由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。

#### （七）利润分配的决策程序和机制

董事会应结合公司盈利情况、资金需求等提出利润分配预案；董事会在审议利润分配预案时，认真研究和论证利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

公司利润分配预案经公司董事会审议通过后，提交股东会以普通决议方式审议决定。股东会对利润分配预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股

东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

### **（八）利润分配调整的决策机制和程序**

公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## **二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况**

### **（一）最近三年利润分配情况**

#### **1、2022 年年度利润分配情况**

2023 年 5 月 4 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度权益分派方案为：拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。因公司可转换债券处于转股期，以截至 2023 年 3 月 31 日总股本 437,099,178 股测算，本次利润分配拟合计派发现金红利 10,927,479.45 元。在实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 0.25 元的分红比例，对分红总金额进行调整。2023 年 6 月 28 日，公司以 2023 年 6 月 27 日为登记基准日，以公司总股本 437,115,519 股为基数，合计派发现金股利 10,927,886.53 元（含税）。

#### **2、2023 年年度利润分配情况**

2024 年 5 月 9 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度权益分派方案为：拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。因公司可转换债券处于转股期，以截至 2024 年 3 月 31 日总股本 437,135,321 股测算，本次利润分配拟合计派发现金红利 8,742,706.42 元。在实施利

润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每 10 股派发现金股利 0.20 元的分红比例，对分红总金额进行调整。2024 年 6 月 18 日，公司以 2024 年 6 月 17 日为登记基准日，以公司总股本 437,136,995 股为基数，合计派发现金股利 8,742,739.90 元（含税）。

### 3、2024 年年度利润分配情况

2025 年 5 月 9 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### （二）最近三年现金分红统计

2022 年度、2023 年度和 2024 年度，公司现金分红情况如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红金额（含税）	0.00	8,742,739.90	10,927,886.53
合并报表中归属于母公司股东的净利润	-73,673,891.83	21,120,670.68	30,325,748.34
现金分红占归属于母公司股东的净利润的比例	0.00%	41.39%	36.04%
最近三年累计现金分红合计			19,670,626.43
最近三年归属于母公司股东的年均净利润			-7,409,157.60
最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例			-265.49%

公司最近三年现金分红情况符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （三）最近三年未分配利润的使用情况

2022 年度、2023 年度和 2024 年度，公司实现的归属于母公司股东的净利润分别为 3,032.57 万元、2,112.07 万元和-7,367.39 万元，在提取盈余公积和年度分红后，当年的剩余未分配利润结转到下一年度，用于日常生产经营，保持公司的可持续发展。

### 三、公司未来三年股东分红回报规划

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资的理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规及规

范性文件和《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，公司董事会制订了《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》，具体内容如下：

### **（一）公司股东分红回报规划制定考虑的因素**

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

### **（二）公司股东分红回报规划制定原则**

1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，遵循重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展原则。公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）和独立董事的意见，在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件的情况下，公司优先采取现金方式分配利润。

2、公司优先采用现金分红的利润分配方式在符合相关法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

### **（三）未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划**

#### **1、利润分配方式**

公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。

#### **2、现金分红的条件**

（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）预期实施现金分红后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要；

（4）公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

#### **3、现金分红的比例**

公司应保持利润分配的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当

年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：

（1）公司未来十二个月内拟进行对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 3000 万元；

（2）公司未来十二个月内拟进行对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

具体每个年度的分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，由公司股东会审议决定。

#### **4、利润分配的期间间隔**

在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

#### **（四）利润分配的决策程序和机制**

董事会应结合公司盈利情况、资金需求等提出利润分配预案；董事会在审议利润分配预案时，认真研究和论证利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

公司利润分配预案经公司董事会审议通过后，提交股东会以普通决议方式审议决定。股东会对利润分配预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问

题。

审计委员会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

#### （五）利润分配调整的决策机制和程序

公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### （六）公司利润分配的信息披露

公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

## 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺

### 一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明

根据公司未来发展规划、行业发展趋势，综合考虑公司的资本结构、融资需求以及资本市场发展情况，除本次向特定对象发行外，公司未来十二个月内不排除安排其他股权融资计划。若未来公司基于业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

### 二、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：

#### （一）本次发行摊薄即期回报分析的假设前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；

2、假设公司2026年12月完成本次发行，该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时间构成承诺，最终以实际完成发行时间为准；

3、假设本次向特定对象发行股票数量为149,093,466股。仅考虑本次发行的影响，不考虑公积金转增股本、股权激励、股票回购注销、可转债转股等其他因素影响，本次发行完成后公司总股本为646,071,688股。此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终发行数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，由公司股东会授权董事会及其授权人士根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

4、假设本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 45,000.00 万元，暂不考虑发行费用等因素的影响。本次向特定对象发行 A 股股票实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

5、根据公司 2026 年 1 月 29 日披露的《2025 年度业绩预告》，归属于上市公司股东的净利润为 1,860.00 万元到 2,780.00 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2,937.00 万元到 3,857.00 万元（上述 2025 年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告为准），假设按区间中值测算，预估公司 2025 年度扣除非经常性损益前、后归属于上市公司股东的净利润分别为 2,320.00 万元、3,397.00 万元。上述测算不代表公司 2025 年盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

假设公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在预估的 2025 年度相应财务数据基础上按照-10%、0%、10% 的业绩增幅分别测算（该假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不代表对公司经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测）；

6、假设不考虑本次向特定对象发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响；

7、上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；公司实际经营情况受国家政策、行业发展等多种因素影响，存在不确定性；投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

## （二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设情况，公司测算了本次发行对公司主要财务指标的影响如下：

项目	2025年度/2025年12月31日（预计）	2026年度/2026年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
总股本（股）	496,978,222	496,978,222	646,071,688
<b>假设1：2026年度净利润较2025年度下降10%</b>			
归属于母公司股东的净利润（元）	23,200,000.00	20,880,000.00	20,880,000.00
扣非后归属于母公司股东的净利润（元）	33,970,000.00	30,573,000.00	30,573,000.00
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	0.03

稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	0.03
扣非后基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.05
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	0.05

**假设2：2026年度净利润较2025年度持平**

归属于母公司股东的净利润(元)	23,200,000.00	23,200,000.00	23,200,000.00
扣非后归属于母公司股东的净利润(元)	33,970,000.00	33,970,000.00	33,970,000.00
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.04
扣非后基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.05
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0.05

**假设3：2026年度净利润较2025年度增长10%**

归属于母公司股东的净利润(元)	23,200,000.00	25,520,000.00	25,520,000.00
扣非后归属于母公司股东的净利润(元)	33,970,000.00	37,367,000.00	37,367,000.00
基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.04
扣非后基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.06
扣非后稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	0.06

注：①基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定计算；

②本次发行前总股本为截至2025年12月31日数据。

本次向特定对象发行股票完成后，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，导致本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险。

**(三) 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示**

本次募集资金到位后，由于本次发行后公司总股本和净资产将会相应增加，募集资金投资项目体现经营效益需一定的时间，在总股本和净资产均增加的情况下，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。

特别提醒投资者理性投资，关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对2025年、2026年归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进

行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

### **三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性**

本次募集资金投资项目有利于公司优化业务结构，提高行业地位，增强公司核心竞争力及盈利能力。本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行业发展趋势和未来发展战略，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及公司全体股东的利益。

本次向特定对象发行股票的必要性和合理性具体参见本预案“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之内容。

### **四、本次募投项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的情况**

#### **(一) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系**

公司是一家专注于新材料技术研发、生产、销售与服务的材料科技企业，致力于在新型合金功能复合材料领域为客户提供全方位的解决方案。报告期内，公司研发、生产和销售的产品包括电接触材料、金属基功能复合材料、硬质合金材料、铜箔及半导体蚀刻引线框架材料。

本次募集资金投资项目包括锂电铜箔及电子铜箔扩产项目、半导体蚀刻引线框架项目。

公司现有铜箔业务主要产品是锂电铜箔。2024年，公司铜箔业务实现收入1.59亿元。本次募投项目中的锂电铜箔及电子铜箔扩产项目，主要产品包括锂电铜箔及电子铜箔。其中，锂电铜箔是对公司现有铜箔业务产能的扩大，而电子铜箔则是在现有产品基础上的积极升级，标志着铜箔业务应用领域的扩展。募投项目的实施可以提升公司铜箔产品供应能力，更好地满足大客户的多样化需求。

浙江宏丰半导体新材料有限公司主要从事半导体蚀刻引线框架材料的研发、生产和销售。截至目前，公司已经完成半导体蚀刻引线框架材料的研发、技术积累和小批量生产，相关产品已送客户试用。本次募集资金到位后，公司将增加对半导体蚀刻引线框架项目的投入，加快产品的产业化落地及产能扩大，提升公司在该领域的竞争力。

综上，本次募集资金投资项目均围绕公司现有主营业务展开，有助于公司扩大经营规模，增加主要产品产能，拓宽产品应用领域，可以增强公司抗风险能力，从而进一步提升盈利水平和核心竞争力，实现公司长期可持续发展。

## （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

### 1、人员储备

铜箔及半导体蚀刻引线框架，属于涉及多门学科的高技术产业，是技术密集型行业，需要专业人才对技术研发的持续支持。一项技术从研发到应用，这不仅要求技术人员具备扎实的理论功底，还要具备丰富的实际制造经验。制造工人也需要通过长期的经验积累和不断的实践磨合，才能掌握复杂的工艺诀窍。

公司始终致力于构建学习型组织，实施系统化的人才培养计划。通过将外部培训与内部培训相结合、系统学习与自主学习相融合的方式，不断加强技术团队和管理团队的能力建设。依托与知名高校及研究院所建立的产学研合作平台，结合内部培养机制，打造了一支研发水平较高、技术能力全面、实践经验丰富且稳定的研究队伍。在人才梯队建设方面，公司注重培养复合型人才，建立了较为合理的人才储备体系。通过系统化的人才培养机制，培育了一批具有战略视野和创新精神的领军人才，带领团队不断开拓创新，为公司保持技术领先优势和实现高质量可持续发展提供了坚实保障。

本次募投项目的实施可以充分利用公司现有的人员储备。同时，为满足业务发展需要，公司将继续加快推进人才招聘和培养计划，不断提高人员专业素养，以应对业务规模扩大所带来的管理和人才需求。公司已为募集资金投资项目的实施储备了充足的人力资源，相关核心人员的丰富经验将有力保证募集资金投资项目的顺利实施。

### 2、技术储备

公司自成立以来始终专注于合金材料的研发与制造。作为国家级高新技术企业，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，依托国家级博士后工作站和省级重点企业研究院两大研发平台，与浙江大学、厦门大学、中南大学、北京工业大学等高等院校、科研院所建立了紧密的产学研合作关系，为新产品开发和客户的定制化需求提供了强有力的技术支撑。截至本预案公告日，公司及子公司累计获得有效授权专利 145 项，其中发明专利 110 项（含国际发明专利 13 项）、实用新型专利 35 项（含德国实用新型专利 1 项、澳大利亚创新专利 1 项、日本实用新型专利 1 项、韩国

实用新型专利 1 项）。此外，公司作为主要起草单位，主导或参与制定了 21 项国家标准、69 项行业标准、3 项团体标准。

截至本预案公告日，公司及子公司在铜箔业务领域拥有授权专利 7 项，另有 6 项专利正在申请中，覆盖铜箔生产工艺、产品性能等多个关键技术领域；半导体蚀刻引线框架领域，实现了半导体蚀刻引线框架与电接触复合材料的研发与生产产业链的纵向延伸和技术协同，掌握了卷对卷连续高精度图案蚀刻的核心技术、卷式无掩膜激光直写曝光（LDI）生产技术、金属表面处理技术等核心技术。上述核心技术和专利技术共同构成了本次募投项目实施的技术基础。

因此，公司的较强的研发能力及技术储备，为本次募集资金投资项目的实施提供了有力支撑和保障。

### 3、市场储备

公司通过完善产业布局，构建了以电接触功能复合材料为核心、延伸发展金属基功能复合材料、硬质合金材料、铜箔材料以及半导体蚀刻引线框架材料五大产业板块协同发展格局。

公司在主营业务领域内积累了众多优质的客户资源，与正泰电器、德力西、施耐德、西门子、ABB、艾默生、森萨塔、伊顿等国内外知名厂商建立了深入的合作关系。报告期内公司对新能源产业链中的客户销售额稳步增长，半导体引线框架产品已送下游客户试用。本次募投项目产品可以利用现有客户的示范效应，进一步满足现有客户需求的同时发掘潜在目标客户，可快速切入对应领域。

综上，公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件，募集资金到位后，公司将按照计划推进募集资金投资项目的投资建设。

## 五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施

为保护投资者利益，保证本次发行募集资金的有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提升公司经营业绩，实现公司业务的可持续发展和对股东的合理投资回报，公司拟采取如下填补措施：

### （一）加强募集资金管理，确保募集资金使用合法合规

为保障公司规范、有效使用募集资金，公司将根据《公司法》《证券法》《上市

公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，确保公司规范、有效使用募集资金。

## （二）加快募投项目实施进度，提高资金使用效率

董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景和盈利能力。本次募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，增强未来几年的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。

## （三）完善公司治理架构，强化内部控制管理

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，持续完善内控制度建设，为公司发展提供制度保障。同时，公司将进一步加强企业经营管理、内部控制，优化预算管理流程，降低运营成本，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升整体经营效率和盈利能力。

## （四）完善利润分配制度，优化投资者回报机制

公司按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》，对公司利润分配、未来分红回报规划作出了明确规定，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利，完善了董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。本次向特定对象发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极给予投资者合理回报，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

公司提醒投资者，以上填补回报措施不代表对公司未来利润任何形式的保证，敬请广大投资者注意投资风险。

**六、公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺**

## （一）公司控股股东、实际控制人出具的承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人承诺如下：

“1、本人承诺依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行A股股票实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。”

## （二）公司董事、高级管理人员出具的承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司的董事、高级管理人员作出以下承诺：

“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司或股东利益；

3、本人承诺对职务消费行为进行约束；

4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

5、本人承诺将在自身职责和权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人承诺如公司未来拟实施股权激励，将在自身职责和权限范围内，促使公司拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

7、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或深圳证券交易所（以下简称“深交所”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监

会/深交所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会/深交所的最新规定出具补充承诺；

8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。”

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2026年2月12日